



Society for the Advancement of Material and Process Engineering

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-21-10 アーバン大塚 3F (株) ガリレオ内 先端材料技術協会
Tel:03-5907-3750 Fax:03-5907-6364 E-mail: g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL:www.sampejapan.gr.jp

SAMPE JAPAN 会員各位殿

SAMPE Japan コンポジット委員会

コンポジット委員会 第 55 回研究会のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

日頃は当協会の活動にご支援、ご協力を賜りまして、心より御礼申し上げます。

このたび、コンポジット委員会 第 55 回研究会を下記の通り開催することになりました。熱可塑性コンポジットが注目される中、下記ホットな話題についてご講演いただけることになりました。つきましては、ご参加いただき、積極的な討論のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時: 2013 年 12 月 13 日(金)10 時 00 分～19 時 30 分

場 所: 同志社大学(今出川校地 室町キャンパス)寒梅館 地下 A 会議室
〒602-0023 京都市上京区烏丸上立売下ル

申込み: 準備の都合上、12 月 5 日(木)までに、お申し込みください。

申込み先:

SAMPE Japan コンポジット委員会事務局 (FAX : 0773-62-8939 、
E-Mail:ktanaka@mail.doshisha.ac.jp)

または

SAMPE Japan 事務局(FAX:03-5907-6364、E-Mail: g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp)
(FAX または E-mail にてお申し込みください)

参加費: 会員 ¥8,000、非会員 ¥12,000

【プログラム】

<10:00-10:10>

開会の辞 コンポジット委員会 委員長

名古屋大学 山根 正睦

<10:10-11:20>

1.「ガラス長繊維強化熱可塑性コンポジットシートの技術開発動向について」

クオドラント・プラスチック・コンポジット・ジャパン株式会社 吉田 智晃 様

<11:20-12:30> 昼食

<12:30-13:40>

2.「繊維強化熱可塑性複合材(NEOMATEX)について」



Society for the Advancement of Material and Process Engineering

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-21-10 アーバン大塚 3F (株) ガリレオ内 先端材料技術協会
Tel:03-5907-3750 Fax:03-5907-6364 E-mail: g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL:www.sampejapan.gr.jp

倉敷紡績株式会社 粕谷 明 様

<13:40-14:50>

3. 「開織技術を利用した熱可塑性複合材料について」

サカイオーベックス株式会社 竹内 博紀 様

<14:50-15:10> 休憩

<15:10-16:20>

4. 「抄紙技術を利用した熱可塑性複合材料の創製」

株式会社クラレ 遠藤 了慶 様

<16:20-17:30>

5. 「K 2013 報告」

同志社大学 田中 和人

<17:30-17:40>

閉会の辞

同志社大学 田中 和人

<17:45-19:30>

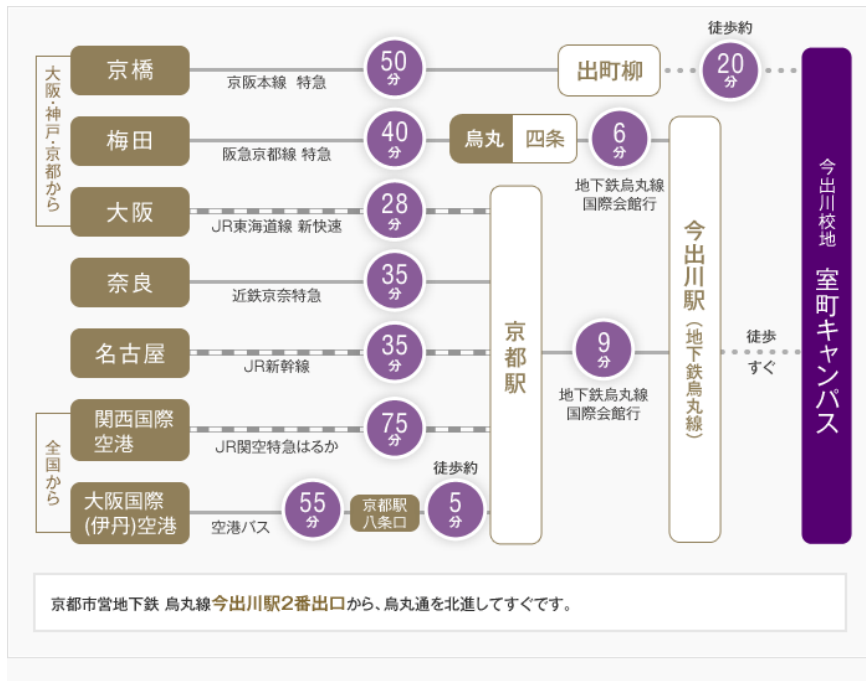
情報・名刺交換会 寒梅館 7階 セカンドハウス will

以上

【会場アクセス】

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/muromachi.html>





コンポジット委員会 第55回研究会 参加申込用紙

SAMPE Japan コンポジット委員会事務局
(FAX:0773-62-8939、E-Mail: ktanaka@mail.doshisha.ac.jp)

または

SAMPE Japan 事務局
(FAX:03-5907-6364、E-Mail: g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp)
(FAX または E-mail にてお申込みください)

参加申込締め切り: 2013年12月5日(木)

・コンポジット委員会 第55回研究会に参加します。

・情報・名刺交換会(17:45-19:30)に【参加します. 参加しません.】

[いずれかを消して下さい]

会社名:

所属:

郵便番号:

TEL:

住所:

FAX:

氏名:

E-mail: